

電子公文

檔 號：

保存年限：

國立臺灣科技大學 函

機關地址：106臺北市基隆路4段43號
聯絡人：謝碧倫
聯絡電話：02-2730-3678

受文者：國立勤益科技大學

發文日期：中華民國111年6月20日

發文字號：臺科大人推字第1110104082號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(附件一 A09610000Q0000000_A095M0000Q111010408200-1.pdf)

主旨：本中心訂於本(111)年7月11日至8月4日辦理「111年半導體封裝製程專業實務技能培訓營研習課程」，敬邀貴校教師踴躍報名參與並給予出席人員公(差)假，惠請查照。

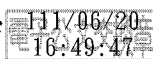
說明：

一、檢送「111年半導體封裝製程專業實務技能培訓營研習課程」說明一份，請依規定於期限內完成報名。

二、線上報名連結<https://forms.gle/jqbJD6ehE79BMLMY9>。

正本：各技專校院、各公私立高級職業學校

副本：本校研究發展處人才推升中心



國立勤益科技大學

第1頁，共5頁



1110056151 111/06/20

111 年半導體封裝製程專業實務技能培訓營研習課程

壹、目的

為培育優秀封裝測試工程師人才，本培訓營結合明新科技大學半導體封裝測試類產線及企業講師，針對電子封裝、IC 元件信號連接方式、IC 封裝製程、先進封裝及封裝設備等，開設一系列課程以提升參與教師對現今產業實務專業技能的認知，研習過程中教師們也可近距離參觀各操作機台及體驗生產線上實際環境。

辦理單位

- 一、指導單位：教育部
- 二、主辦單位：教育部促進產學連結合作育才平臺-國立臺灣科技大學執行辦公室
- 三、協辦單位：明新科技大學半導體學院類產線計畫辦公室

參、參與對象

★ 全國技專校院教師、技術性高中教師職相關領域或有興趣之教師

肆、課程資訊

- 一、課程時間：111 年 7 月 11 日至 8 月 4 日(可依主題內容任選研習天數，建議參與 16 小時(含)以上)
- 二、課程地點：明新科技大學明學樓 205 教室、半導體封裝測試類產線基地
- 三、報名截止日：即日起至額滿為止
- 四、報名網址：<https://forms.gle/jqbJD6ehE79BMLMY9>
- 五、課程人數：限 20 名
- 六、研習內容及流程：

天數	日期 星期	時間	研習內容	主持人/主講人	辦理地點
第一天	7 月 11 日 星期一	09:00-12:00	IC 產業發展	明新科技大學 呂明峰 教授	明學樓 205 教室 半導體封裝 測試類產線 基地
		13:00-16:00	晶圓切割機系統概要及參數設置	明新科技大學 何宗穎 講師	
第二天	7 月 12 日 星期二	09:00-12:00	半導體製程技術	明新科技大學 呂明峰 教授	
		13:00-16:00	刀具拆裝操作及檢測機制調整	力成科技(股)公司 何信松 講師	
第三	7 月 13 日 星期三	09:00-12:00	半導體構裝技術的演變	力成科技(股)公司 蔡天寶 講師	



天		13:00-16:00	切割成品的前置作業設定	力成科技(股)公司 何信松講師
第四天	7月14日 星期四	09:00-12:00	半導體封裝製程	明新科技大學 趙守嚴 副教授
		13:00-16:00	晶圓切割機台實機操作	力成科技(股)公司 何信松講師
第五天	7月18日 星期一	09:00-12:00	半導體信號重置製程	明新科技大學 趙守嚴 副教授
		13:00-16:00	黏晶機系統概要及參數設置	明新科技大學 何宗穎講師
第六天	7月19日 星期二	09:00-12:00	3D 封裝製程	明新科技大學 趙守嚴 副教授
		13:00-16:00	彈匣及軌道傳送定位及校正	力成科技(股)公司 林賢昇 講師
第七天	7月20日 星期三	09:00-12:00	先進封裝製程	明新科技大學 趙守嚴 副教授
		13:00-16:00	黏晶的前置作業設定	力成科技(股)公司 林賢昇 講師
第八天	7月21日 星期四	09:00-12:00	晶圓級封裝製程	明新科技大學 趙守嚴 副教授
		13:00-16:00	黏晶機台實機操作	力成科技(股)公司 林賢昇 講師
第九天	7月25日 星期一	09:00-12:00	面板級封裝製程	明新科技大學 趙守嚴 副教授
		13:00-16:00	打線機系統概要及參數設置	明新科技大學 何宗穎講師
第十天	7月26日 星期二	09:00-12:00	先進封裝的製程發展	工研院/電子與光電 系統研究所/ 王欽宏 組長
		13:00-16:00	瓷嘴更換及調整	力成科技(股)公司 黃志賢 講師
第十一天	7月27日 星期三	09:00-12:00	先進封裝的技術挑戰	工研院/電子與光電 系統研究所/ 張香鉉 經理
		13:00-16:00	打線機彈匣及軌道定位調整	力成科技(股)公司 黃志賢 講師
第十二天	7月28日 星期四	09:00-12:00	半導體的封膠方法及環保製程	明新科技大學 趙守嚴 副教授
		13:00-16:00	打線機實機操作	力成科技(股)公司 黃志賢 講師
第十	8月1日 星期一	09:00-12:00	晶圓切割機操作能力檢測	力成科技(股)公司 何信松 講師



三天		13:00-16:00		
第十四天	8月2日 星期二	09:00-12:00	固晶機操作能力檢測	力成科技(股)公司 林賢昇 講師
		13:00-16:00		
第十五天	8月3日 星期三	09:00-12:00	打線機操作能力檢測	力成科技(股)公司 黃志賢 講師
		13:00-16:00		
第十六天	8月4日 星期四	09:00-12:00	半導體封裝製程學習評量	力成科技(股)公司 蔡天寶 講師
		13:00-16:00	半導體封裝機台實務操作評量	

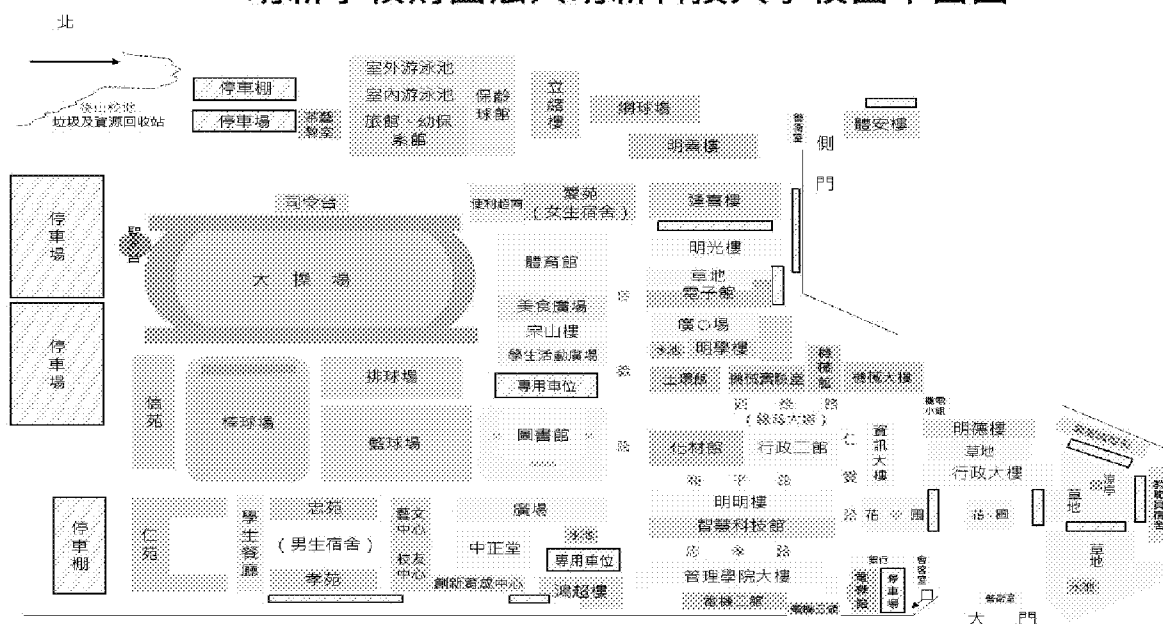
伍、注意事項

- 一、活動全程免費，依實際參與情形核予研習時數。
- 二、本活動受疫情關係影響，執行單位有權利調整課程教學內容及上課模式。
- 三、為維護講師智慧財產權，研習進行中未經講師同意請勿拍照、錄音或錄影，謝謝配合。
- 四、聯絡人：教育部促進產學連結合作育才平臺-國立臺灣科技大學執行辦公室謝小姐，電話：02-27303678，電子郵件：pilun66@mail.ntust.edu.tw。

陸、交通資訊

明新科技大學 地址：30401 新竹縣新豐鄉新興路 1 號

明新學校財團法人明新科技大學校園平面圖





● 行車建議路線

1. 中山高湖口交流道下(83.8 公 里出口)，往湖口、新豐方向行駛，遇士林電機(丁字路口)右 轉 400 公尺後，再左轉走新興路(省道台一線)， 經新豐火車站約 900 公尺，抵達明新科技大學。
2. 中山高竹北交流道下(91.0 公 里出口)，往竹北市區方向行駛，走光明六路，遇中華路(省道台一線)右 轉往新豐方向，經竹北派出所後約 4 公里即可抵達明新科技大學。

● 大眾運輸工具

1. 高鐵：高鐵新竹站下車，轉搭「快捷 5 號」高鐵至湖口工業區，在新興路（明新科技大學）站下車。
2. 火車：可搭電車至新豐火車站，出車站大門左轉，步行約 15 分鐘即可抵達本校。
3. 巴士：可選擇搭乘新竹客運、中壢客運或豪泰客運至本校。
 - a. 搭乘新竹客運班車，路線可選擇「新竹-湖 口」、「新竹-中壢(經新豐)」 以及「新竹-新庄子(經新豐)」， 於新竹、中壢火車站附近上車，明新科技大學下車。
 - b. 搭乘中壢客運班車，路線為「中壢-新 竹」，可於新竹、中壢火車站附近上車，明新科技大學下車。
 - c. 搭乘豪泰客運班車，路線為「台北-明 新科技大學(經北二高)」，起訖站分別為台北市政府附近(世貿三館) 與 明新科技大學。
 - d. 搭「快捷 5 號」高鐵至湖口工業區，在新興路（明新科技大學）站下車。

